4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月19日10時30分
⑵　開催場所　東北大学未来科学技術共同研究センター１階小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 12
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Wafer Polishing Equipment 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　φ300㎜ wafer support : A combined specification for φ200㎜-φ300㎜ wafers, supporting grinding, chemical mechanical polishing (CMP), high-level cleaning and edge trimming.
B　Configuration : A 4-axis unit for rough grinding (Z1), finishing (Z2), CMP (Z3) and CMP finishing (Z4).
C　Cleaning functions : Support for the following chemicals.
Alkaline chemicals (SC-1, etc.), acidic chemicals (citric acid, etc.) and ozone water.
Moreover, the equipment should have a mechanism allowing brush-cleaning of the wafer surface (ground surface) using a PVA brush.
D　Particle countermeasures : The unit should have a fan filter unit (FFU) installed with a ULPA filter.
E　Supported thickness for workpiece transfer : Maximum supported total workpiece thickness : 1.5㎜ or more.
F　Non-contact thickness measurement : In-process non-contact workpiece thickness measurement.
G　Process load control : Controlling the contact pressure by a pressure sensor during CMP. (Detectable load range : 0～2,000 N)
H　Chuck table : A chuck table with a water-cooling mechanism.
I　Transfer arm clamp : The transfer arm for ground wafer should be an edge-clamp type instead of a vacuum type. Moreover, wet transfer is used using deionized water to prevent the ground surface from drying during transfer.
J　Edge trimming
a　Edge trimming for before／after wafer bonding.
b　Cleaning with ozone water after grinding
c　Support for half cut dicing
d　Support for half-cutting of φ200mm-φ300mm wafers.
K　Slurry : Support for the following types of slurry
Composition : Alkaline, organic alkaline ; Abrasive : Silica
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 20, January, 2012
⑹　Contact point for the notice : Higuchi Hideki, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年 12 月 12 日
国立大学法人大阪大学総長　平野　俊夫
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　27
**○第１号**
1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量
スーパーコンピュータシステム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入目的　本システムは大学等の広範囲にわたる学術研究に対して、大規模かつ超高速の演算処理機能を提供するため、全国共同利用施設である本学サイバーメディアセンター大規模計算システムの一部として導入するものである。
⑸　導入予定時期　平成25年度７月以降
⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　スーパーコンピュータとして、世界的な尺度で第一線級の処理能力を有し、それを維持可能なシステムであること。
B　現有スーパーコンピュータシステムＮＥＣ　ＳＸ－８ＲおよびＳＸ－９の20倍以上の能力を有し、同システムとFortran 90言語のソースコード・レベルで互換性を有すること。
C　主記憶容量は200ＴＢ以上であること。
D　ファイル・システムは８ＰＢ以上であること。
E　ネットワーク・システムは、本システム内及び外部を、安全に安定してかつ高速に接続できること。
F　研究者が手元で使っているデスクトップ・ワークステーションとの親和性を有し、そのバックエンド・システムとして大規模な計算機資源を提供可能であること。
G　現有システムにおいて提供されているライブラリやアプリケーションによって提供されている機能を包含するソフトウェアを備えていること。データ解析・可視化及びデータアーカイブ機能を備えていること。
H　全国共同利用施設としてのサイバーメディアセンターの責務を果たすために必要な運用管理機能及び保守支援体制を持っていること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月25日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒565―0871 吹田市山田丘１－１ 大阪大学財務部吹田調達センター室調達第二係　柳生　弘和　電話06―6879―4010
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年12月12日から平成24年１月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月15日11時00分
⑵　開催場所　大阪大学サイバーメディアセンター本館３階大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Super Computer System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The product must have performance in the highest level in the world and it must be able to keep that.
B　The total processing performance of the product must be 20 at least times greater than the NEC SX-8R and SX-9 that we have used before, and it must be compatible with the Fortran90 source code in our system.
C　The main memory must be 200 TBytes or larger.
D　The total amount of external disk storage must be 8 PBytes or larger.
E　The product must be equipped with secure, stable and high-speed network systems for internal and external connections.
F　The product must be friendly with desktop workstations that researchers use, while providing huge computational resource as their back-end system.
G　The product must have softwares including both the function of libraries and applications which our system have provided. And it must have the functionalities of data analysis, visualization and archiving.